

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/093256 A1

553581

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01R 13/03

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004100

(22) Internationales Anmeldedatum:  
17. April 2004 (17.04.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 18 890.8 17. April 2003 (17.04.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AMI DODUCO GMBH [DE/DE]; Im Altgefäß 12, 75181 Pforzheim (DE). WIELAND-WERKE AG [DE/DE]; Graf-Arco-Strasse 4, 89070 Ulm (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KASPAR, Franz [DE/DE]; Uhlandstrasse 21, 75223 Niefern-Öschelbronn (DE). GANZ, Joachim [DE/DE]; Mauerackerstrasse 11, 75399 Kapfenhardt (DE). BURESCH, Isabell [DE/DE]; Bgm.-Wanner-Strasse 62, 89257 Illertissen (DE).

(74) Anwälte: TWELMEIER, Ulrich usw.; Zerronnenstrasse 23-25, 75172 Pforzheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

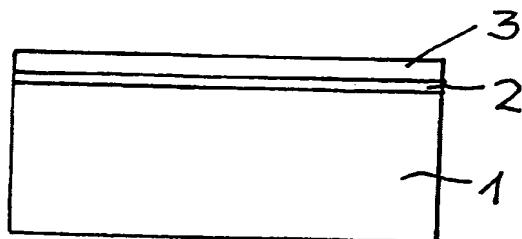
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ELECTRICAL PLUG CONTACTS AND A SEMI-FINISHED PRODUCT FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE STECKKONTAKTE UND EIN HALBZEUG FÜR DEREN HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a semi-finished product for producing plug contacts in plug connectors for electric direct-current systems in motor vehicles, which are operated with a nominal voltage at which arcs can arise. The semi-finished product comprises an electrically conductive base body, which is made of a non-precious metallic material and which supports, at least in part, a contacting coating made of a material that is more precious than the material of the base body. According to the invention, the coating has a thickness of at least 0.3 µm and is made of silver or of a silver-based alloy with an additive that, together with the silver or with the silver-based alloy, does not form any alloy or, at most, forms a precipitation alloy and has a higher melting point than silver.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Halbzeug für die Herstellung von Steckkontakten in Steckverbindern für elektrische Gleichstromnetze in Kraftfahrzeugen, die mit einer Nennspannung betrieben werden, bei welcher Lichtbögen entstehen können, mit einem elektrisch leitfähigen Grundkörper aus einem unedlen metallischen Werkstoff haben welcher wenigstens teilweise eine kontaktgebende Beschichtung aus einem Material trägt, welches edler ist als das Material des Grundkörpers. Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass die Beschichtung wenigstens 0,3 µm dick ist und aus Silber oder aus einer Silberbasislegierung mit einem Zusatz besteht, welcher mit dem Silber bzw. mit der Silberbasislegierung keine Legierung oder allenfalls eine Ausscheidungslegierung bildet und einen höheren Schmelzpunkt als Silber hat.

BEST AVAILABLE COPY

